

HDI 高速激光微细钻孔机 简要说明



型号：SLDR-8070I

规格参数

HDI 高速激光微细钻孔系统

型号：SLDR-8070I

行业应用

- 1、PCB 行业 HDI 钻孔
- 2、贴片电感陶瓷钻孔
- 3、半导体微电子行业 TSV 工艺微细钻孔
- 4、发动机喷油嘴钻孔

机器优点

- 1、采用皮秒激光器，超短脉冲加工无热传导，适于陶瓷薄膜材料的高速钻孔。
- 2、采用单激光器双光路分光技术，双激光头加工，效率提升一倍。
- 3、钻孔速度高达 2000 holes/s，最小孔径 10 μm ，真圆度 95%以上，小孔边缘光滑无毛刺。
- 4、CCD 视觉预扫描&自动抓靶定位、最大加工范围 650mm \times 450mm、XY 平台拼接精度 $\leq \pm 3 \mu\text{m}$ 。
- 5、支持多种视觉定位特征，如十字、实心圆、空心圆、L 型直角边、影像特征点等。
- 6、全自动上下料系统实现无人操作。
- 7、10 年激光微细加工系统研发设计技术积淀，性能稳定，无耗材。

序号	项目	技术参数
光学单元		
1	激光器类型	355、1064nm 可选
2	冷却方式	恒温水冷
3	激光功率	10-100W
4	光束质量	$M^2 < 1.3$
5	聚焦方式&加工头数	平场聚焦镜&双头
6	最小聚焦光斑直径	$\Phi 8 \mu\text{m}$